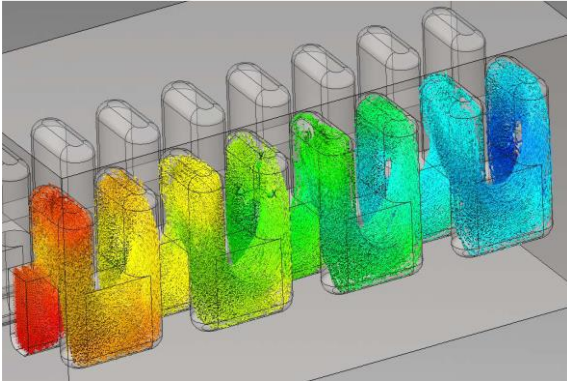
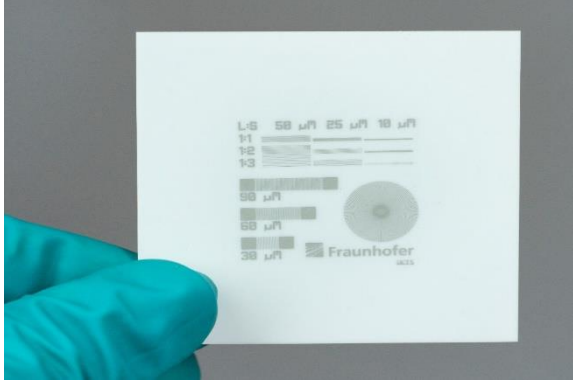

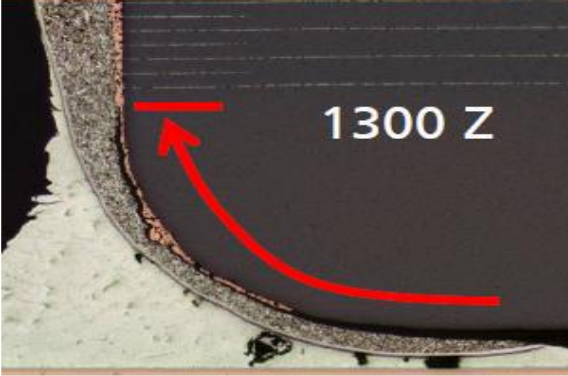


**Tab. 1. Themen und Schwerpunkte der IMAPS Konferenz**

Entwurf, Modellierung, Simulation	Materialien und Prozesse
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektrisches und elektromagnetisches Design</li> <li>• Thermisches und thermomechanisches Design</li> <li>• Fertigungs- und testgerechtes Design</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Substratmaterialien und Oberflächenschichtsysteme</li> <li>• Herstellung von Verdrahtungsträgern</li> <li>• Verbindungstechnologien (Flip Chip, CoB, SMT, Embedding, ...)</li> <li>• Schutz-, Verguss- und Verkapselungsprozesse und -material</li> </ul>
<p><i>IMAPS-Jahreskonferenz 2021 Beispiel:  <b>„Optimierung eines Flüssigkeitskühlers“</b>            (Bennet Lorbeer, FH Kiel)</i></p>	<p><i>IMAPS-Jahreskonferenz 2021 Beispiel:  <b>„Fotostrukturierbare Pasten“</b>            (Kathrin Reinhardt – Preisträgerin „Best Presentation“, Fh IKTS)</i></p>
	
Technologien der Systemintegration	Qualität und Zuverlässigkeit
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wafer Level Packaging (CSP, SiP, ...)</li> <li>• Substrate Level Packaging (System on Board, Embedding, ...)</li> <li>• MEMS / Sensor-Packaging</li> <li>• Optoelektronisches Packaging</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prozessüberwachung / Teststrategien</li> <li>• Prüfsysteme</li> <li>• Thermomechanische Zuverlässigkeit</li> <li>• Zuverlässigkeit bei kombinierten Beanspruchungen</li> </ul>
<p><i>IMAPS-Jahreskonferenz 2021 Beispiel:  <b>„Hochintegriertes SiC-Leistungsmodul“</b>            (Jan Stolley, FH Kiel)</i></p>	<p><i>IMAPS-Jahreskonferenz 2021 Beispiel:  <b>„Zuverlässigkeit großer MLCC-Bauformen“</b>            (Simon Schambeck, BMW Group)</i></p>
	

**Wir vergeben auch dieses Jahr einen Best Presentation Award!**  
*(Dies gilt nur für die Präsenzveranstaltung!!)*